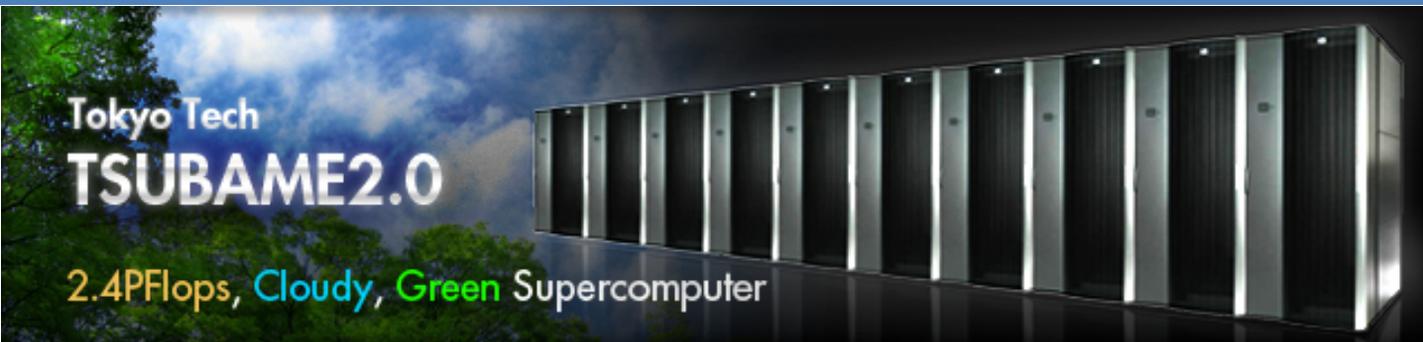


平成24年度 東京工業大学 TSUBAME 共用促進シンポジウム



開催日時：平成24年9月20日（木）13時30分～17時00分

開催場所：東京工業大学 蔵前会館（Tokyo Tech Front）1階 蔵前ホール（大岡山駅前）

定員：150名（事前参加登録制）

参加登録：<http://www.gsic.titech.ac.jp/sympoH24registration>

参加費：無料

主催：東京工業大学 学術国際情報センター

プログラム：

13:00～13:30 受付

13:30～13:40 開会挨拶

飯塚 久夫（東京工業大学 理事・副学長（渉外・情報担当/産学連携推進本部長）

13:40～13:55 来賓挨拶

柿田 恭良（文部科学省 研究振興局 基盤研究課長）

13:55～14:10 スパコン産業利用におけるTSUBAMEの役割

青木 尊之（東京工業大学 学術国際情報センター 副センター長）

14:10～14:40 成果報告1「鋼材強化に資する微細析出物成長の計算機シミュレーション」

澤田 英明（新日本製鐵株式会社 先端技術研究所）

14:40～15:10 成果報告2「Li-グラファイト層間化合物のステージ構造変化に関する

ハイブリット量子古典シミュレーション」

大庭 伸子（株式会社 豊田中央研究所 無機材料研究部 材料設計研究室）

15:10～15:40 成果報告3「メソ構造を持つ高分子材料のマルチスケール・シミュレーション」

本田 隆（日本ゼオン株式会社 総合開発センター 基盤技術研究所）

15:40～15:45 休憩（コーヒープレイク）

15:45～16:45 ポスターセッション

平成23年度実施課題11件

16:45～16:55 課題公募状況報告

佐々木 淳（東京工業大学 学術国際情報センター）

16:55～17:00 総括、閉会挨拶

佐伯 元司（東京工業大学 学術国際情報センター センター長）

17:15 TSUBAME見学会（希望者のみ）

問合せ先：東京工業大学 学術国際情報センター 共同利用推進室

TEL：03-5734-2085 E-mail：kyoyo@gsic.titech.ac.jp

URL：<http://www.gsic.titech.ac.jp/H24Symp>



TSUBAME

Tokyo Institute of Technology